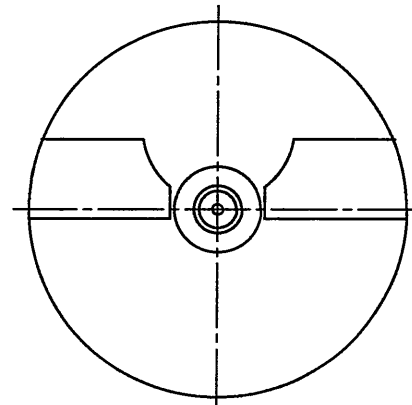
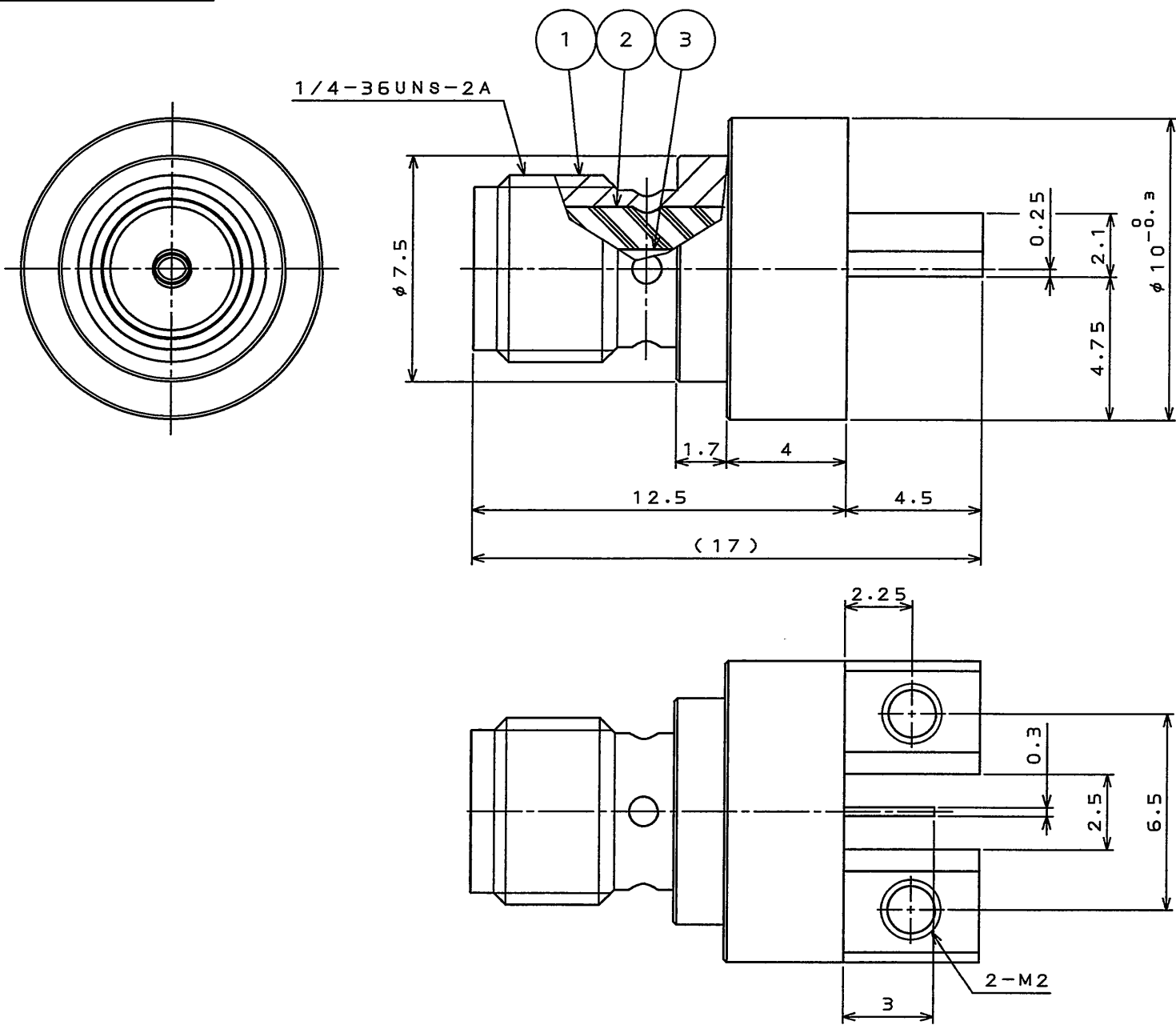


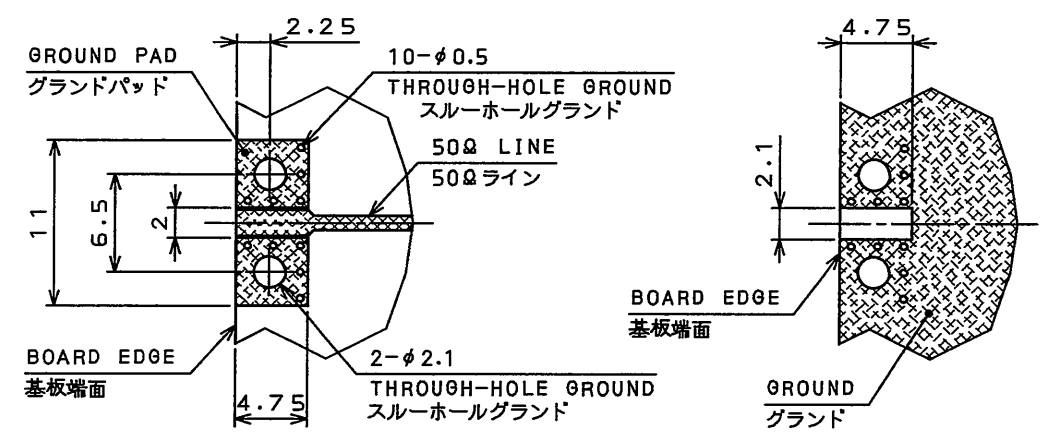
87021118
 (ON 0NIMVHD)台要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



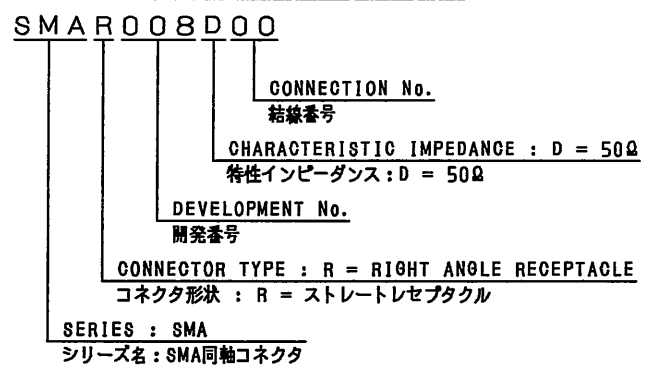
NOTE1. THIS CONNECTOR IS FIXED WITH M2 SCREWS BETWEEN THIS CONNECTOR AND PCB.
 2. PIN CONTACT IS SOLDERED WITH 50Ω LINE. (SOLDER CONNECTION OF CONNECTOR AND GROUND PADS IS UNNECESSARY.)

注1. 基板への取付けはM2ねじを用いて行います。
 2. ピンコンタクトと50Ωラインは半田付けにて接続します。(コネクタとグランドパッドとの半田付けは不要です。)



CONNECTOR MOUNTING SIDE
 コネクタ実装面
 GROUND SIDE
 グランド面
 MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
 取付穴参考寸法 (SCALE 2:1)

DESIGNATION 命名法



3	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	Ni: 1.5μm MIN. Au: 0.1μm MIN.
2	INSULATOR	1	PTFE		
1	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	Ni: 1.5μm MIN.
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JAGS-20118		第1版 (ORIGINAL DATE) 19.Jul.2011		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) SMA
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	名称 (TITLE) SMAR008D00		
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK. R.KATOU	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
. ±0.8	° ±	査閲 APPD. K.FURUKATSU			
.X ±0.4	°X ±	承認 APPD. T.HIYASHITA			
.XX ±0.1		質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ112028		
.XXX ±			版数 (REV.) 1		

DOF-0-212F(05.08)

